

证券代码：603077

证券简称：和邦生物

公告编号：2023-74

四川和邦生物科技股份有限公司关于控股股东 部分股份解除质押及部分股份质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东四川和邦投资集团有限公司（以下简称“和邦集团”）持有公司的股份数量为1,963,779,103股，占公司总股本比例22.24%。截至本公告披露日，和邦集团累计质押的股份数量为1,035,000,000股，占其持股总数比例为52.70%，占公司总股本比例为11.72%。

● 和邦集团及其一致行动人贺正刚先生合并持有公司股份总数为2,376,411,103股，占公司总股本比例的26.91%。截至本公告披露日，和邦集团及其一致行动人贺正刚先生合并质押的股份数量为1,035,000,000股，占其持股总数比例为43.55%，占公司总股本比例为11.72%。

近日，公司收到和邦集团关于将其持有本公司的部分股份解除质押及部分股份质押的通知，现将相关情况公告如下：

一、本次股份解质的基本情况

股东名称	四川和邦投资集团有限公司
本次解质股份（股）	317,000,000
占其所持股份比例	16.14%
占公司总股本比例	3.59%
解质时间	2023年11月20日
持股数量	1,963,779,103股
持股比例	22.24%
剩余被质押股份数量（注）	1,035,000,000股

剩余被质押股份数量占其所持股份比例	52.70%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	11.72%

注：和邦集团在同日办理了部分股份解除质押及质押，上表中剩余被质押股份数量为本次解除质押及质押后的股份数量。

二、本次股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押数量(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押资金用途
和邦集团	是	106,000,000	否	否	2023年11月20日	2026年11月16日	重庆农村商业银行股份有限公司两江分行	5.40%	1.20%	补充流动资金
		110,000,000			2023年11月20日	2026年11月16日		5.60%	1.25%	
		101,000,000			2023年11月20日	2026年11月16日		5.14%	1.14%	

本次质押的股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途等情况。

三、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

截至本公告披露日，和邦集团及其一致行动人贺正刚先生累计质押股份情况如下：

单位：股

股东名称	持股数量	持股比例	本次解质及质押前累计质押数量	本次解质及质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
和邦集团	1,963,779,103	22.24%	1,035,000,000	1,035,000,000	52.70%	11.72%	0	0	0	0

贺 正 刚	412,632,000	4.67%	0	0	0	0	0	0	0	0
合 计	2,376,411,103	26.91%	1,035,000,000	1,035,000,000	43.55%	11.72%	0	0	0	0

四、控股股东股份质押情况

1、控股股东未来半年和一年内到期的质押股份情况及控股股东资金偿还能力、还款资金来源及具体安排。

和邦集团未来半年内到期的质押股份数量为 108,000,000 股，占其所持有股份比例的 5.50%，占公司总股本比例为 1.22%，对应融资余额为 1.18 亿元；和邦集团未来一年内到期的质押股份数量为 108,000,000 股，占其所持有股份比例的 5.50%，占公司总股本比例为 1.22%，对应融资余额为 1.18 亿元。

和邦集团资信情况良好，具备相应的资金偿还能力，未来上述股票质押期限届满，将采取包括但不限于到期滚动还款等方式实现质押风险在可控范围之内，其还款资金来源主要包括企业经营所得、分红款等。

2、控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3、本次股份解质及质押事项不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力等生产经营及公司治理产生影响。控股股东本次质押及解质的股份不涉及业绩补偿义务。

上述质押事项若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 22 日